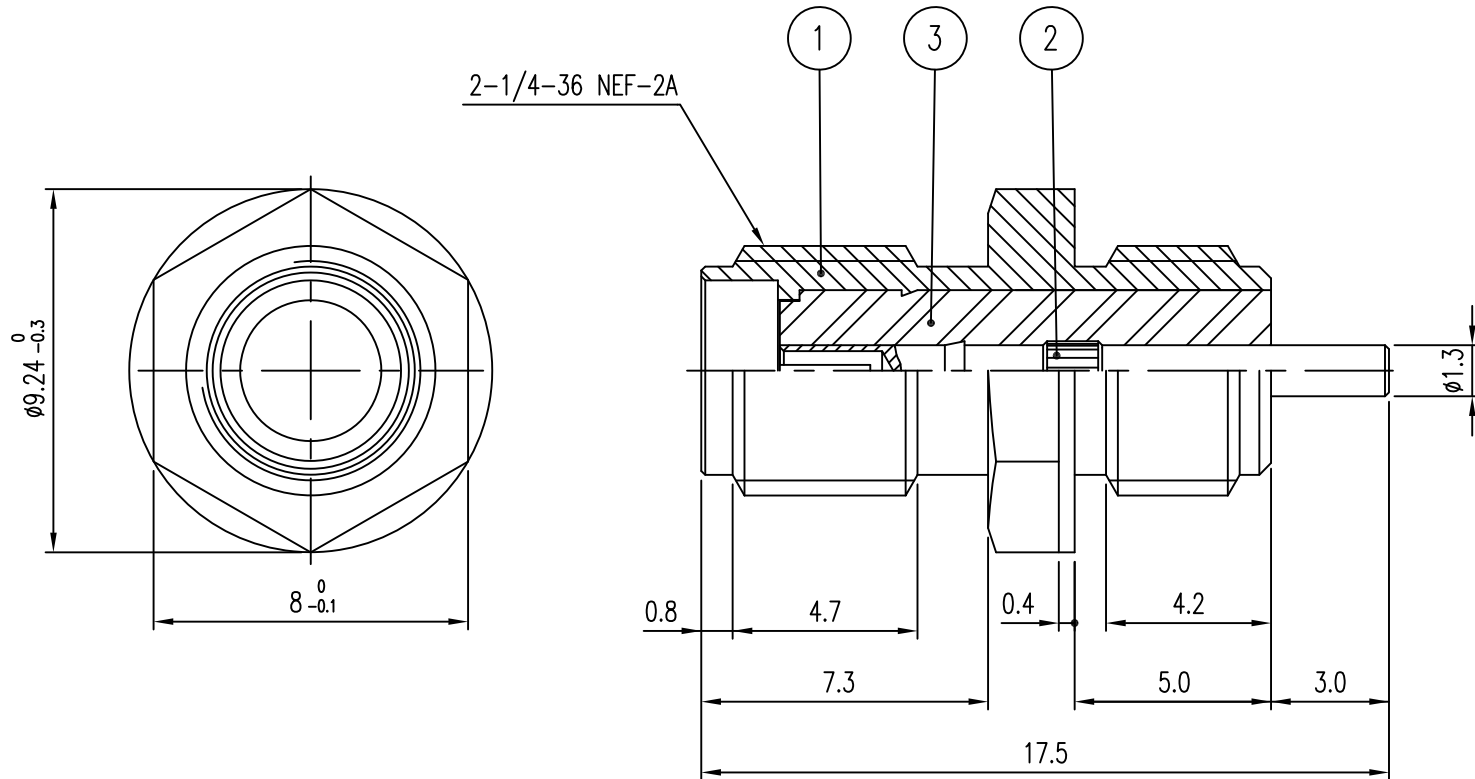


기공 ST										수 정 내 용				
									부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)									1	바디 공용화로 인한 부품 코드 변경	은선영	김인철	2019. 10. 07.	
ST(개선)									2	PIN 공용화 제품 적용으로 인한 코드 변경	은선영	김선호	2022. 08. 23.	



주 기

1. A부 가시미 작업

1 2 1	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02877-N/1 DIN00200-N/1 (H2237)		
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01423-5/1 DCT00193-5/1		
	1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00318-5/4 DBD00318-135/1 (D2300)		
대체가능재질		품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05		년월일 2004. 11. 23.			KJ  COMTECH KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
		승인						
재질		검도			도명 SJ-NUT			
		제도						
열처리		작성부서			A4			
		연 구 소						
보호피막처리		적도 5/1	단위 mm	총량	도번 CN00113-7/1 K314-518-005			